

2026 台積公司模組副工程師 學年實習計畫

徵才條件



- 專為在校生規劃，對象為大學四年級
- 科系：機械、動機、電機、電子、光電、機電、模具、自動化、飛機、車輛、電輔、機械設計、半導體工程、光電半導體、先進應用材料、智慧機器人工程、化工與材料工程、電通、資工等理工科系尤佳
- 具備問題解決、溝通表達、團隊精神、主動學習

工作內容&福利



- 負責半導體產品線機台設備維修及保養
- 管理及改善機台零件系統、零件備品管理
- 設計機台保養制具及流程改善以增進機台穩定性
- 優於同業的整體薪酬，實習結束後有機會轉正



[Submit Resume](#)

- Deadline: 2026/02/15
- 履歷檢附大學成績單

